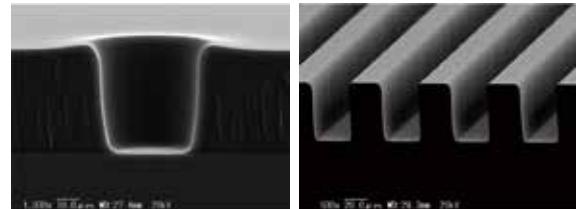


## 8

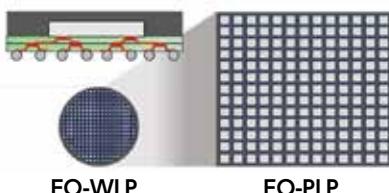
## 感光性接着剤 VPA series

## 半導体パッケージ製造工程用 仮接着材

- 強い接着力を有するネガタイプのレジスト(接着剤)
- レーザー剥離で容易に剥離可能
- 硬化膜は高い絶縁性と耐熱性を示す

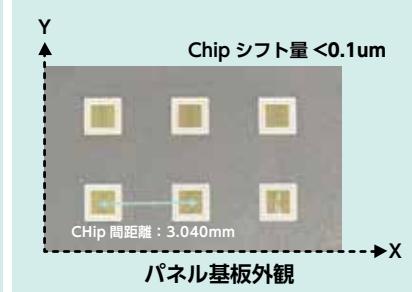
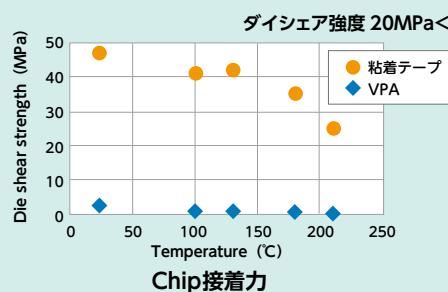
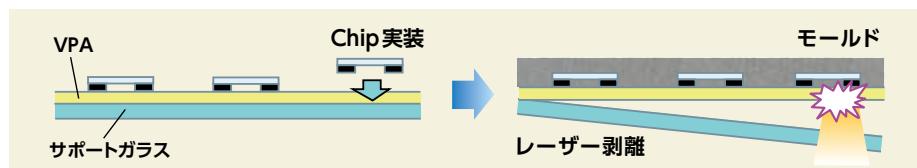


## Fan-Out Package

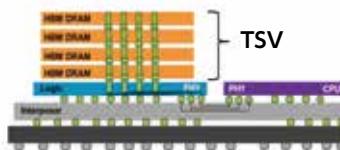


高耐熱、高接着性により、モールド時のChipシフトを抑制

優れた実装精度を実現

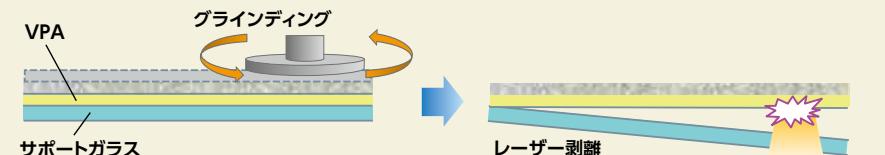


## TSVウェハグラインディング

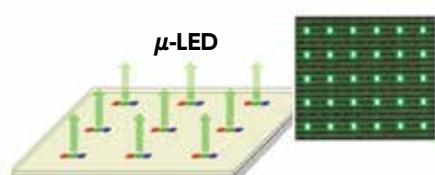


高充填、高接着性により、グラインディング時、クラックの発生を抑制

ウェハの薄化が可能



## μ-LEDのレーザートランスファー



レーザーリリース性、高接着性、高いLEDキャッチ性

優れたLED転写精度を実現

